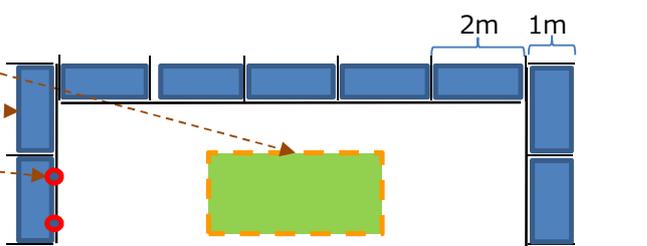


SEMICON	概要	世界8カ国*で開催されている半導体業界最大規模の展示会で、幅広い製品や技術に関する、グローバルで質の高い展示を体感することができる *SEMICON Japan, Korea, China, Singapore, Russia, West(US), Taiwan, Europe
	詳細	名称 : SEMICON Japan 2018 期間 : 2018年12月12日(水)、13日(木)、14日(金)の3日間 会場 : 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟 主催 : SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) URL : http://www.semiconjapan.org/ja/
The高専@SEMICON実施概要	趣旨・目的	モノづくり意欲の高い高専生の研究成果発表機会を提供し、職業意識の醸成、将来を見据えた業界研究促進、企業と高専との技術交流活性化を図る
	期間	2018年12月12日(水)、13日(木)、14日(金)の3日間
	場所	SEMICON Japan 2018 会場内 MIRAI GAKKO 展示エリア
	対象	全国高等専門学校在籍の学生(本科/専攻科)
	展示内容	大人の技術者達を驚かせるような、固定観念にとらわれない、アイデアにあふれた技術や研究成果の展示 ※パネル展示だけでなく、研究成果の実機、実物の展示があると尚良い
	貸出	パッケージブース 2m(間口) x 1m(奥行) x 2.7m(高さ) ・システム壁面 ・展示台(W180xD600xH730) ・学校名サイン(角ゴシック体を予定) ・2口コンセント(100V500W*まで) x1個 [*応相談] ・照明(スポットライト) x2灯 ◆ブースイメー ブースTOPに「The高専」の看板を掲げます 展示デスク (180cm x 60cm) スポットライト (各ブースx2) 
	準備品(学校側)	必須 : 研究発表に必要な物品・パネル・パソコン等 任意 : 学校ロゴタイプ・ロゴマーク等
	プレゼンテーション	ブースにて来場者に対し研究内容の発表を実施 ※プレゼンテーション方法は自由 [例] 実機デモンストレーション、パネルやパソコンを使ってプレゼンなど
協賛金	協賛企業より1校あたり30万円支給 ※参加学生、引率教員の旅費交通費および物品の輸送費としてご活用ください	
懇親会	2018年12月13日(木)18時頃より「東京ベイ有明ワシントンホテル」にて開催(参加費無料)	
応募要項	対象 :	「ものづくり」に関する研究全般 ※半導体製品の活用や半導体製造に関するテーマ歓迎
	展示 :	上記「貸出」スペース範囲内で展示できる内容
	締切 :	2018年9月21日(金) 17時 ※締め切り後の申し込みは受け付けておりませんのでご注意ください
	応募 :	申込用紙*に必要事項記入のうえ応募いただきます *問い合わせ窓口までご連絡ください(E-Mailにて送付します)
	備考 :	出展可否は、協賛企業による厳正な審査のうえ10月初旬を目途に連絡します
協賛	SEMIジャパン 株式会社荏原製作所 株式会社フジキン 株式会社日立ハイテクノロジーズ 株式会社堀場製作所	株式会社ニコン 株式会社日本マイクロニクス SCREENグループ 株式会社ディスコ 東京エレクトロン株式会社 (順不同)
お問い合わせ窓口	TEL 東京エレクトロン株式会社 会社名 : 東京エレクトロンFE株式会社 (担当: 人事総務部 滝田・弓田) 住所 : 〒183-8705 東京都府中市住吉町2-30-7 電話 : TEL : 0120-33-8285 FAX : 042-333-8495 E-Mail : tfepdrecruit@tel.com	